



Conferința de Tehnologie de Integrare a Sistemelor Electronice ESTC 2022

În perioada 13-16 septembrie 2022, a avut loc cea de-a XIX-a ediție a Conferinței de Tehnologie de Integrare a Sistemelor Electronice ESTC 2022, care s-a desfășurat la Sibiu. ESTC este una dintre cele trei conferințe premium din domeniul *semiconductor packaging* din întreaga lume și un eveniment internațional de prim rang în domeniul packaging-ului electronic și al integrării sistemelor. Conferința este organizată o dată la doi ani și este conferința emblematică a IEEE EPS (Electronics Packaging Society of IEEE) din Europa, susținută în asociere cu IMAPS Europe, alături de Universitatea Politehnica București (UPB), Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) și Academia Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" Sibiu.

În cifre, cei peste 350 de participanți din 30 de țări, au avut parte de peste 110 prezentări orale în cele 20 de sesiuni tehnice, 10 keynote speakers, 7 ateliere de lucru, 4 cursuri de dezvoltare profesională (PDC), 33 de expozanți din industrie și o vizită la sponsorul principal al ESTC 2022, Continental Automotive Systems România.

Printre participanții de marcă la aceasta conferință, se numără președinta IEEE Electronics Packaging Society, Kitty Pearsall, președinta IMAPS North America, Beth Keser și președintele IMAPS Europe, Daniel Nilsen Wright.

În deschiderea conferinței a fost organizat primul IEEE EPS & NTC (Electronics Packaging Society & Nanotechnology Council) Summit, în cadrul căruia au participat studenți din 9 SBC-uri (Student Brand Chapter) din România, Ungaria și Bulgaria.

Domeniile de interes din acest an ale conferinței au fost: Advanced Packaging, Materials for Interconnects and Packaging; Reliability of Electronic Devices and Systems; Power Electronics System Packaging, Optoelectronic System Packaging; Assembly and Manufacturing Technologies; RF, mm-wave, and TH Systems Packaging; Flexible, Printed and Hybrid Electronics; Advanced Technologies for Emerging Systems; Design Tools and Modelling; Biomedical Application Packaging; Global Education for Electronics.

Ținând cont de nivelul științific al conferinței și de modul de organizare al acesteia, membrii comitetului au fost recompensați cu o diplomă de recunoaștere a meritelor acordată de președintele IEEE Electronics Packaging Society, Kitty Pearsall. Implicată direct, UTCN a fost reprezentată în comitetul de organizare al conferinței de domnul decan al facultății de Electronică, Telecomunicații și tehnologia Informației, Prof.dr.ing. Ovidiu Pop, în calitate de vicepreședinte.

